(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2011 年 9 月 15 日(15.09.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/111565 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/02 (2006.01) *H01L 21/683* (2006.01)
H01L 21/677 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2011/054606

(22) 国際出願日: 2011 年 3 月 1 日(01.03.2011)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2010-051911 2010 年 3 月 9 日(09.03.2010) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社(TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目３番１号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 西林 孝浩 (NISHIBAYASHI, Takahiro) [JP/JP]; 〒8611116 熊本県合志市福原１－１ 東京エレクトロン九州株式会社内 Kumamoto (JP). 岩下 泰治 (IWASHITA, Yasuharu) [JP/JP]; 〒8611116 熊本県合志市福原１－１ 東京エレクトロン九州株式会社内 Kumamoto (JP). 田村 武 (TAMURA, Takeshi) [JP/JP]; 〒8611116 熊本県合志市福原１－１ 東京エレクトロン九州株式会社内 Kumamoto (JP). 北山 殖也(KITAYAMA, Tatsuya) [JP/JP]; 〒8611116 熊本県合志市福原１－１ 東京エレクトロン九州株式会社内 Kumamoto (JP).

(74) 代理人: 金本 哲男, 外(KANEMOTO, Tetsuo et al.); 〒1620065 東京都新宿区住吉町１－２０ 角張ビル はづき国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

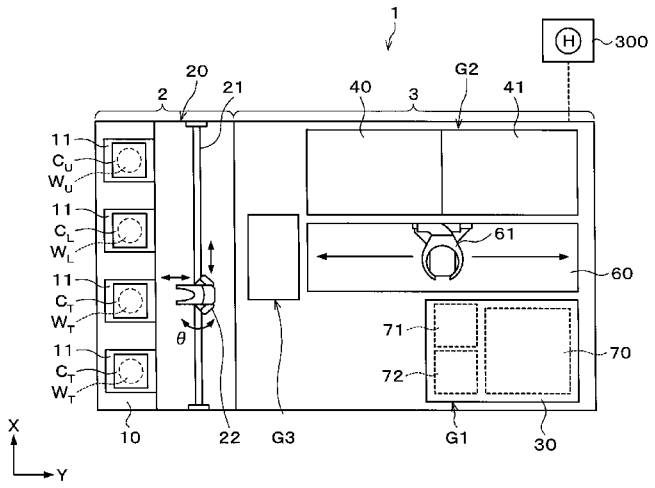
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,

[続葉有]

(54) **Title**: JOINING SYSTEM, JOINING METHOD, PROGRAM AND COMPUTER MEMORY MEDIA

(54) 発明の名称 : 接合システム、接合方法、プログラム及びコンピュータ記憶媒体

[図1]



(57) **Abstract**: A joining system has a conveyance in/out station that can retain a plurality of substrates or a plurality of polymerized substrates, and conveys a substrate or polymerized substrate into and out of a processing station; and a processing station that implements a predetermined process on a substrate and that joins substrates. The processing station has a surface activation apparatus that activates a substrate surface; a surface-hydrophilizing apparatus that hydrophilizes and cleans a substrate surface; a joining apparatus that joins substrates together; and a conveyance region for conveying the substrate or the polymerized substrate to the surface-activation apparatus, the surface-hydrophilizing apparatus, and the joining apparatus.

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2011/111565 A1

NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）

接合システムは、複数の基板又は複数の重合基板を保有可能で、且つ処理ステーションに対して基板又は重合基板を搬入出する搬入出ステーションと、基板に所定の処理を行い、基板同士を接合する処理ステーションとを有している。処理ステーションは、基板の表面を活性化する表面活性化装置と、基板の表面を親水化すると共に洗浄する表面親水化装置と、基板同士を接合する接合装置と、表面活性化装置、表面親水化装置及び接合装置に対して、基板又は重合基板を搬送するための搬送領域とを有している。